

Microchip、ハイレゾ オーディオ機器開発に向けたソニーLDAC™テクノロジー対応 Bluetooth®オーディオ SoC を発表

Audeze 社のハイエンド ゲーミング ヘッドフォン Mobius で没入型オーディオ サウンドを実現する
Bluetooth 5.0 準拠 SoC

2018 年 8 月 2 日[NASDAQ: MCHP] — メインストリーム コンシューマ市場で高品質なオーディオ体験への需要が高まる中、途切れる事のない没入型リスニング体験が可能な Bluetooth オーディオ機器が要求されています。しかし Bluetooth オーディオ設計に使われてきた既存のコーデック(音声の無線伝送のために使われる通信および圧縮技術)は、しばしばビット深度と周波数レートの制約を受けてきました。こうしたオーディオ システム設計に向け、Microchip Technology Inc. (日本支社: 東京都港区浜松町、代表: 吉田洋介 以下 Microchip 社)は本日、ソニー株式会社(以下ソニー)の LDAC オーディオ コーデック テクノロジー*をサポートした認証済み Bluetooth 5 準拠システムオン チップ(SoC)である IS2064GM-0L3 を発表しました。この SoC により、先進のコーデックを採用した新世代のオーディオ機器を開発し、ハイレゾ オーディオを一部のオーディオマニアだけでなく Bluetooth 無線製品のマスマーケットへと拡大できます。高級ヘッドフォン メーカーの Audeze 社は、この SoC をハイエンド ゲーミング ヘッドフォン Mobius に実装しました。IS2064GM-0L3 の詳細は <http://www.microchip.com/IS2064>を参照してください。

Audeze 社のヘッドフォン Mobius の Bluetooth 無線接続には、LDAC を含む各種オーディオ コーデック インターフェイスをサポートした Microchip 社の IS2064GM-0L3 SoC が採用されています。ソニーの LDAC は現在最高品質のオーディオ コーデックとして定評があります。データ送信スループットは標準 Bluetooth SBC (Sub-band Codec)の 3 倍の最大 990 kbps に達し、周波数とビット深度は最大 96 kHz/24 ビットを維持できます。この高い圧縮効率と再現性が Bluetooth オーディオ機器でもハイレゾ オーディオのリスニング体験を可能にします。

「弊社の新型ヘッドフォン Mobius は画期的な技術を数多く採用しています。高品質の Bluetooth オーディオを実現するため Microchip 社の IS2064GM-0L3 SoC を実装しました」と Audeze 社 CEO の Sankar Thiagasamudram 氏は述べています。「Microchip 社の卓越したサポートのおかげで LDAC コーデックを短期間で簡単に製品に組み込みました。」

IS2064GM-0L3 SoC によってこれまで以上に多くの市場のオーディオ製品メーカーが LDAC を利用できるようになります。しかも Microchip 社の優れたグローバル技術サポートと包括的な開発環境によって実装が容易になり、開発期間を短縮できます。LDAC コーデックは Android 8.0 Oreo™オペレーティング システムの Bluetooth スタックにも統合されており、LDAC テクノロジーに対応した送信機器の数は増えています。

「Microchip 社は、いつでもどこでも気軽に利用できる Bluetooth 無線で高品質オーディオを体験したいという消費者ニーズの高まりに応えられるように OEM を支援しています」と Microchip 社無線ソリューション部

Microchip、ハイレゾ オーディオ機器開発に向けた LDAC 対応 Bluetooth オーディオ SoC を発表
2-2-2-2

門副社長の Steve Caldwell は述べています。「音質を重視したオーディオ製品への取り組みを強化して頂く中で、Microchip 社製品なら Bluetooth 無線をシームレスに統合できる事を実感して頂けるでしょう。」

開発ツール

IS2064GM-0L3 は、お申し込み頂いた後に承認手続きを経て出荷いたします。開発ボードも提供いたします。

在庫/供給状況

IS2064GM-0L3 は本日より 8x8 mm LGA パッケージで量産出荷を開始いたします。LDAC テクノロジーの使用に関する追加のライセンス要件は、ソニー社 (www.sony.net/Products/LDAC/index.html) にお問い合わせください。

詳細は Microchip 社または正規販売代理店にお問い合わせ頂くか、Microchip 社のウェブページをご覧ください。
メール BTAudio@microchip.com でのお問い合わせも受け付けています。

Microchip 社の Bluetooth オーディオ全製品の詳細は www.microchip.com/design-centers/wireless-connectivity/bluetooth/applications/audio を参照してください。

リソース

高画質の写真は報道関係専用窓口までお問い合わせ頂くか、Flickr でご覧ください(掲載に許可は不要です)。

- アプリケーション画像: www.flickr.com/photos/microchiptechnology/43218806091/sizes/
- 製品画像: www.flickr.com/photos/microchiptechnology/28349047627/sizes/

Microchip 社について

Microchip 社(NASDAQ:MCHP)は、マイクロコントローラ、ミックスドシグナル、アナログ、Flash-IP ソリューションのトッププロバイダであり、全世界で数千を超える各種アプリケーションで、低リスクの製品開発、総システムコストの削減、迅速な商品化の実現に貢献しています。Microchip 社は本社をアリゾナ州チャンドラーに構え、優れた技術サポート、確かな納期、高い品質を提供しています。詳細は Microchip 社のウェブサイト (<http://www.microchip.com>) をご覧ください。

###

Note: Microchip 社の名称とロゴ、Microchip ロゴは米国およびその他の国における Microchip Technology Incorporated の登録商標です。LDAC はソニー株式会社の商標です。*LDAC オーディオ コーデック テクノロジーの実装には、ソニービデオ&サウンドプロダクツ株式会社から別途ライセンスが必要です。Android 8.0 Oreo は Google LLC 社の商標です。その他本書に記載されている商標は各社に帰属します。

詳細については、以下にお問い合わせください。
Daphne Yuen (Microchip 社): (852) 2943 5115
(メール: daphne.yuen@microchip.com)

大川、仙場 (共同 PR): (03) 3571 5236
(メール: taito.okawa@kyodo-pr.co.jp)

報道関係者の方へ: このニュースリリースのメールによる配信については、共同 PR 株式会社 大川もしくは仙場まで電話(03) 3571 5236 またはメール taito.okawa@kyodo-pr.co.jp でお問い合わせください。